

Title (en)  
Thermal shock resistant moulded pouring part and process for its manufacture

Title (de)  
Wärmeschockbeständiges Ausgiessformteil und Verfahren zu seiner Herstellung

Title (fr)  
Pièce de coulée résistant au choc thermique et son procédé de fabrication

Publication  
**EP 1348505 A1 20031001 (FR)**

Application  
**EP 02447051 A 20020329**

Priority  
EP 02447051 A 20020329

Abstract (en)  
A component for the casting of liquid metal comprises a base body of refractory material including external and internal surfaces defining a channel for casting the liquid metal. At least part of the internal surface of the component is coated with an insulating coating forming a layer impermeable to gas, on contact with the liquid metal. An Independent claim is also included for a method for the coating of such a casting component.

Abstract (fr)  
La présente invention concerne une pièce pour la coulée d'un métal liquide, comprenant un corps de base en matériau réfractaire, ledit corps comprenant une surface externe et une surface interne définissant un chenal pour la coulée du métal liquide. Cette pièce est caractérisée en ce qu'au moins une partie de sa surface interne est revêtue d'un enduit isolant formant, au contact du métal liquide, une couche imperméable aux gaz. Une telle pièce possède une excellente résistance au choc thermique qui lui permet d'être utilisée sans préchauffage. Par après, il se forme une couche réduisant avantageusement sa perméabilité aux gaz.

IPC 1-7  
**B22D 41/54**

IPC 8 full level  
**B22D 41/54** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**B22D 41/54** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)  
• [A] FR 2721241 A1 19951222 - VESUVIUS FRANCE SA [FR]  
• [A] US 4498661 A 19850212 - KOBZAR VLADIMIR E [SU]  
• [A] US 2063377 A 19361208 - GOVERT HELMER  
• [A] US 5681499 A 19971028 - BENSON PAUL M [US], et al

Designated contracting state (EPC)  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)  
**EP 1348505 A1 20031001**; AT E298643 T1 20050715; AU 2003218536 A1 20031013; BR 0308821 A 20050104; DE 60300946 D1 20050804; DE 60300946 T2 20060511; DK 1492639 T3 20051031; EP 1492639 A1 20050105; EP 1492639 B1 20050629; ES 2242160 T3 20051101; PT 1492639 E 20051031; TW 200304856 A 20031016; TW I271239 B 20070121; US 2005156365 A1 20050721; US 7237596 B2 20070703; WO 03082500 A1 20031009

DOCDB simple family (application)  
**EP 02447051 A 20020329**; AT 03711721 T 20030328; AU 2003218536 A 20030328; BE 0300056 W 20030328; BR 0308821 A 20030328; DE 60300946 T 20030328; DK 03711721 T 20030328; EP 03711721 A 20030328; ES 03711721 T 20030328; PT 03711721 T 20030328; TW 92106494 A 20030324; US 50950104 A 20040928